

## Nilson Parra Flores, CommScope

# "El advenimiento de la IA está imponiendo nuevos desafíos a los data centers"

*CommScope se ha posicionado como uno de los principales proveedores en el segmento Hyperscale, Cloud y MTDC con soluciones que facilitan el soporte de las tecnologías actuales y brindan un camino para migrar a las tecnologías futuras de forma no disruptiva. Para conocer más, conversamos con Nilson Parra Flores, RCDD/NTS/DCDC & HCDC - Territory Manager, HSA, Enterprise de CommScope.*

### En términos de conectividad, ¿qué desafíos enfrentan los data centers?

El advenimiento de la IA está imponiendo nuevos desafíos tanto a los data centers que se encuentran en operación, como aquellos que están enfrentando su fase de diseño. Los primeros porque deben enfrentar la incorporación de nuevas tecnologías en términos de equipos activos, que cada vez integran electrónica a mayor escala, demandando mayor consumo de energía y mayor ancho de banda, lo que trae como consecuencia conductores eléctricos de mayor capacidad, mayor generación de calor, mayor cantidad de cables de datos, y la necesidad de extraer el calor generado en un espacio más reducido y cada vez más densamente poblado y rodeado por canalizaciones y cables de todo tipo que dificultan la operación del sistema de enfriamiento.

Los data centers en fase de diseño, si bien tienen la libertad de ser concebidos para albergar estas nuevas tecnologías y demandas de espacio, energía, conectividad y enfriamiento, deben lidiar con las actuales tecnologías y planificar muy cuidadosamente su ruta de migración, para facilitar la transición futura a nuevas tecnologías una vez ya en operación.

### ¿Cómo aseguran que sus soluciones puedan adaptarse a las necesidades cambiantes de los data centers?

Lo hacemos a través de soluciones de muy alta densidad, mayor ancho



de banda y ultra bajas pérdidas que soportan las tecnologías actuales y brindan un camino flexible y adaptable para migrar a nuevas tecnologías, como nuestros cables de fibra óptica Rollable Ribbon que reducen el diámetro de los cables en un 30% respecto a los cables Flat Ribbon, lo que disminuye en un 50% el espacio ocupado en las canalizaciones, y nuestra línea de ODF's PROPEL que provee una solución de muy alta densidad, con acceso frontal y posterior, diseñada para facilitar el intercambio modular de componentes, integrando nuevos tipos de conectores de alta densidad como MPO16 y SN, facilitando su incorporación desde un comienzo o en forma posterior, o incorporar nuevos conectores que puedan emerger y estandarizarse en el futuro.

### ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes?

La IA y el Edge Computing están siendo los principales impulsores en el desarrollo de los procesadores gráficos (o GPU), los que están duplicando su capacidad año tras año, y se espera que en esta década la hayan multiplicado por 1000. Con ello se ha dado impulso al desarrollo de tecnologías complementarias en cuanto a enfriamiento, suministro de energía y conectividad en espacios cada vez más reducidos que, si bien permiten optimizar el uso del espacio, traen consigo la necesidad de un uso diferente del mismo, tanto para los sistemas de enfriamiento que comenzarán a migrar del aire al líquido, como de los cableados de conectividad y sus canalizaciones que deberán reducir el diámetro de los cables, así como el espacio utilizado en rack para su terminación.

### ¿Qué diferencia a CommScope?

Justamente ha sido la conciencia de estas necesidades, unido a la vocación de líder tecnológico de CommScope, la que nos ha hecho los principales fabricantes en este segmento, posicionándonos como uno de los principales proveedores de conectividad para la mayoría de los data centers Hyperscale, Cloud y MTDC a nivel global, y particularmente en Chile, que es un polo de desarrollo tecnológico para la región. Es esta experiencia y conocimiento lo que nos pone a la vanguardia en el desarrollo de soluciones innovadoras con visión de futuro. **G**